

入札参加申込書

住所 _____

社名等 _____

代表者 _____ 印

以下の入札への参加を申し込みます。

件名	X線一般撮影システム RADSpeed PRO EDGE パッケージ 一式 (17号室) (島津製作所社製)
入札期日	平成30年10月12日(金) 午後1時15分